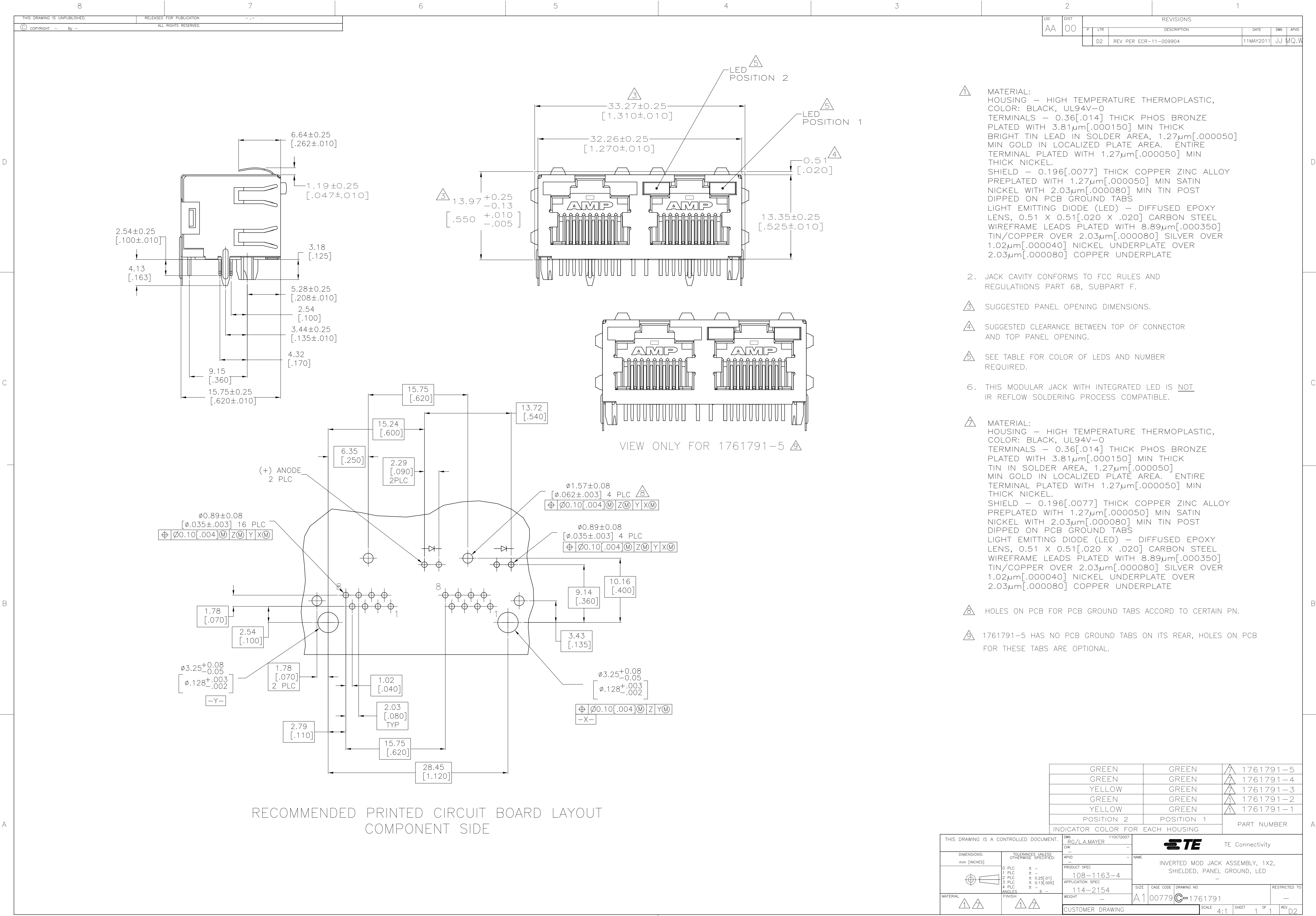




LOC		DIST		REVISIONS			
AA		00		F	LTR	DESCRIPTION	DATE
				D2	REV	PER ECR-11-009904	11MAY2011

1. MATERIAL:
HOUSING — HIGH TEMPERATURE THERMOPLASTIC,
COLOR: BLACK, UL94V-0
TERMINALS — 0.36[.014] THICK PHOS BRONZE
PLATED WITH 3.81µm[.000150] MIN THICK
BRIGHT TIN LEAD IN SOLDER AREA, 1.27µm[.000050]
MIN GOLD IN LOCALIZED PLATE AREA. ENTIRE
TERMINAL PLATED WITH 1.27µm[.000050] MIN
THICK NICKEL.
SHIELD — 0.196[.0077] THICK COPPER ZINC ALLOY
PREPLATED WITH 1.27µm[.000050] MIN SATIN
NICKEL WITH 2.03µm[.000080] MIN TIN POST
DIPPED ON PCB GROUND TABS
LIGHT EMITTING DIODE (LED) — DIFFUSED EPOXY
LENS, 0.51 X 0.51[.020 X .020] CARBON STEEL
WIREFRAME LEADS PLATED WITH 8.89µm[.000350]
TIN/COPPER OVER 2.03µm[.000080] SILVER OVER
1.02µm[.000040] NICKEL UNDERPLATE OVER
2.03µm[.000080] COPPER UNDERPLATE

2. JACK CAVITY CONFORMS TO FCC RULES AND
REGULATIONS PART 68, SUBPART F.

3. SUGGESTED PANEL OPENING DIMENSIONS.

4. SUGGESTED CLEARANCE BETWEEN TOP OF CONNECTOR
AND TOP PANEL OPENING.

5. SEE TABLE FOR COLOR OF LEDS AND NUMBER
REQUIRED.

6. THIS MODULAR JACK WITH INTEGRATED LED IS NOT
IR REFLOW SOLDERING PROCESS COMPATIBLE.

7. MATERIAL:
HOUSING — HIGH TEMPERATURE THERMOPLASTIC,
COLOR: BLACK, UL94V-0
TERMINALS — 0.36[.014] THICK PHOS BRONZE
PLATED WITH 3.81µm[.000150] MIN THICK
TIN IN SOLDER AREA, 1.27µm[.000050]
MIN GOLD IN LOCALIZED PLATE AREA. ENTIRE
TERMINAL PLATED WITH 1.27µm[.000050] MIN
THICK NICKEL.
SHIELD — 0.196[.0077] THICK COPPER ZINC ALLOY
PREPLATED WITH 1.27µm[.000050] MIN SATIN
NICKEL WITH 2.03µm[.000080] MIN TIN POST
DIPPED ON PCB GROUND TABS
LIGHT EMITTING DIODE (LED) — DIFFUSED EPOXY
LENS, 0.51 X 0.51[.020 X .020] CARBON STEEL
WIREFRAME LEADS PLATED WITH 8.89µm[.000350]
TIN/COPPER OVER 2.03µm[.000080] SILVER OVER
1.02µm[.000040] NICKEL UNDERPLATE OVER
2.03µm[.000080] COPPER UNDERPLATE

8. HOLES ON PCB FOR PCB GROUND TABS ACCORD TO CERTAIN PN.

9. 1761791-5 HAS NO PCB GROUND TABS ON ITS REAR, HOLES ON PCB
FOR THESE TABS ARE OPTIONAL.

GREEN	GREEN	1761791-5
GREEN	GREEN	1761791-4
YELLOW	GREEN	1761791-3
GREEN	GREEN	1761791-2
YELLOW	GREEN	1761791-1
POSITION 2	POSITION 1	PART NUMBER
INDICATOR COLOR FOR EACH HOUSING		

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN	RG/LA.MAYER	11OCT2007
		CHK		
		APVD		
DIMENSIONS: mm [INCHES]		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		NAME
		0 PLC ± -		PRODUCT SPEC
		1 PLC ± -		108-1163-4
		2 PLC ± 0.25[.01]		APPLICATION SPEC
		3 PLC ± 0.13[.005]		114-2154
		4 PLC ± -		WEIGHT
		ANGLES		
		FINISH		
MATERIAL		FINISH		
		CUSTOMER DRAWING		SCALE 4:1 SHEET 1 OF 1 REV D2

RECOMMENDED PRINTED CIRCUIT BOARD LAYOUT
COMPONENT SIDE

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9